

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	
时间	2025年5月9日
地点	深圳证券交易所
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 刘先兵 董事会秘书/财务负责人 仇劲松 独立董事 融亦鸣、范春仙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2025年5月9日参加由深圳证券交易所组织召开的以“信通智联.引领新浪潮”为主题的集体业绩说明会。具体问题及回复如下：</p> <p>问题1：公司2024年度和2025年第一季度的经营业绩同比均取得了较大的增长，请问公司实现业绩突破的主要原因是什么？</p> <p>答：公司产品主要应用于半导体领域方向，在2024年度和2025年第一季度，得益于中国半导体市场整体复苏，中国半导体产业规模的快速增长以及设备关键零部件国产化的不断推进，下游半导体领域客户采购需求快速增长，带动了公司先进陶瓷材料结构件产品在半导体领域销售收入规模的增长。</p> <p>同时，半导体设备领域收入的增加也得益于公司“功能-结构”</p>

一体模块化产品的大规模量产。基于多年技术积累、研发及产业化布局，公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代，该“结构-功能”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商CVD设备关键零部件的“卡脖子”问题。公司为半导体晶圆厂商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品，装配于SACVD、PECVD、LPCVD和激光退火等设备，部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。公司“功能-结构”一体模块化产品中，静电卡盘与超高纯碳化硅套件也逐步量产，并已形成了一定的收入。

上述两种因素共同带动了公司经营业绩在2024年度和2025年第一季度快速增长。

问题2：公司“功能-结构”一体模块化产品目前最新的研发和产业化进展如何？2025年在产品推出上会有什么新动作？

答：公司“功能-结构”一体模块化产品主要包括陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件。

陶瓷加热器：多款6寸/8寸/12寸陶瓷加热器已完成验证并投入批量生产，产品涉及多种规格及功能，包括单/双/多区加热，有/无射频，真空/静电吸附，400~650℃等，并装配于SACVD、PECVD、LPCVD、ALD和激光退火等设备；

静电卡盘：8寸和12寸静电卡盘均已完成验证并量产，12寸多区加热静电卡盘即将交付客户测试；

超高纯碳化硅套件：6寸非渗硅套件已于2024年开始量产交付，8寸非渗硅套件已完成半导体设备厂验证，目前正在其终端客户晶圆厂进行推广与测试，12寸渗硅套件中部分部件已完成半导体设备厂验证，其他部件仍然在验证中。

公司陶瓷加热器量产专用线和静电卡盘量产专用线将在苏州先进材料生产基地整合建设，以满足将来从研发转入批量生产的产能需求。公司希望在2025年度，可以完成更多模块化产品

的验证进程，并开始投入正式量产。

问题 3：公司目前募投项目建设进展情况如何？建成后预计将给公司业务带来哪些发展？

答：截至目前，公司募投项目均在稳步推进建设中。位于江苏苏州的先进材料生产基地项目、研发中心建设项目已经完成基建，建筑面积达到 8.2 万平方米，正处于设备购置和安装调试过程中，未来将主要用于生产陶瓷加热器和静电卡盘等“结构-功能”一体化模块产品，其中先进材料生产基地项目预计将在 2025 年内结项并投入使用。位于四川眉山的泛半导体核心零部件加工制造项目就近服务成渝地区大客户，已于 2024 年基建完成。公司募投项目建成后，将有效保障公司对下游客户产品和服务的如期交付，提升公司产品和服务的快速响应能力，同时保证紧跟先进陶瓷行业的发展步伐，巩固并进一步提高公司市场份额和行业地位。

问题 4：珂玛科技在国产化率仅 19%泛半导体陶瓷零部件市场中，公司如何提升份额？

答：未来，公司将继续立足于国内和国际两大市场，聚焦产品升级，重心从以传统陶瓷结构零部件为主，拓展以陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等“功能-结构”一体模块化产品作为核心竞争力，以国际半导体设备先进陶瓷企业为标杆，向国际一流水平的半导体设备关键零部件高技术企业升级转型。在不断加强自主研发的基础上，公司同时也加强对国内细分领域同行的关注，在适当条件下将采取并购等方式，扩充产品线，增强研发能力。

附件清单(如有)	无
日期	2025年5月9日